

Armatura dla przemysłu cukrowniczego

Produkcja cukru –
Maksymalna dyspozycyjność instalacji

1



Właściwy wybór dla procesów produkcyjnych w cukrowni

Rozdrabnianie	Media	Zakres ciśnień	Zakres temperatur	Ścieralność	Korozyjność	Armatura
Przygotowanie						
	Woda, ścieki	1-6 bar	25-50°C	Umiarkowana	Niska	Desponia z dyskiem 4C0 i E wykładziną
Ekstrakcja						
	Woda	1-2 bar	70-80°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
	Sok bogaty w cukier	1-2 bar	70-80°C	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
Wybielanie						
	Sok bogaty w cukier	1-2 bar	100-105°C	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i EC wykładziną
	Mleczko wapienne	1-2 bar	100-105°C	Niska	Wysoka	Desponia® z dyskiem 4C0 i FT wykładziną
	Roztwór siarczynu	1-2 bar	70-80°C	Niska	Wysoka	Desponia® z dyskiem 4C0 i EC wykładziną
Odparowanie						
	Sok klarowany	600 mbarA	60-70°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
	Para	10-20 bar	120-200°C	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i EC wykładziną, Elara z dyskiem 4C0 i TG lub IN uszczelnieniem
	Kondensat wodny	600 mbarA	60-70°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
Krystalizacja						
	Syrop	1 bar	60-70°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
	Para	10-20 bar	120-200°C	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i EC wykładziną, Elara z dyskiem 4C0 i TG lub IN uszczelnieniem
	Woda	1-2 bar	20-25°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E wykładziną
	Kryształy cukru	1 bar	40-70°C	Umiarkowana	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i FT lub FW wykładziną
Suszenie						
	Kryształy cukru	1 bar	40-70°C	Umiarkowana	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i FT lub FW wykładziną
	Gorące powietrze	1-2 bar	50-90°C	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
Rafinacja						
	Surowy cukier	1 bar	Otoczenia	Umiarkowana	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i FT lub FW wykładziną
	Gorąca woda	1-2 bar	70-80°C	Niska	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i E lub EC wykładziną
	Kwas fosforowy, wodorotlenek wapnia, dwutlenek węgla	1 bar	Otoczenia	Niska	Umiarkowana	Desponia® z dyskiem 4C0 i E wykładziną
Pakowanie						
	Cukier surowy, cukier biały	1 bar	Otoczenia	Umiarkowana	Niska	Desponia® z dyskiem 4C0 i FW wykładziną

Desponia®

Przepustnica centryczna z uszczelnieniem elastomerowym



Wykonania korpusu	Wafer, Lug, U-Section
Średnica nominalna	DN 25–1600 (1"–64")
Maks. ciśnienie robocze	Do 16 bar
Połączenie kołnierzowe	PN6, PN10, PN16, ANSI cl. 150, JIS, AS, AWWA, etc.
Zakres temperatur	–20°C do 200°C
Materiały korpusu	Żeliwo sferoidalne
Materiał dysku	Stal kwasoodporna z pokryciem PEKK
Materiały wykładzin	EPDM, NBR, FPM
Specjalne egzekucje	Wykonanie dla stref wybuchowych

Elara

Przepustnica z poswójnym mimośrodem



Wykonania korpusu	Wafer, Lug
Średnica nominalna	DN 50–600 (2"–24")
Maks. ciśnienie robocze	Do 50 bar
Połączenie kołnierzowe	PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI cl. 150/300
Zakres temperatur	–50°C do 400°C
Materiały korpusu	Stal węglowa, Stal Nierdzewna
Materiał dysku	Stal Nierdzewna
Materiał gniazda	MPTFE, metal, ognioodporne
Specjalne egzekucje	Bezsmarowy, certyfikat ATEX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE, misja niezorganizowana zgodnie z ISO 15848-1, DIN3780, MSS-SP-143.

3

Inne wyroby



Zasuwa nożowa

Korpus żeliwny, nóż ze stali nierdzewnej, siedzisko metalowe lub EPDM konstrukcja odporna na zapychanie się korpusu ciałami stałymi zawartymi w pulpie i osadzie.



Przepustnica Bianca wyłożona PTFE

DN 32 – 900, korpus Wafer lub U, korpus ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, dostępny w różnych wykonaniach.



Kurki kulowe

Kurki kulowe 2-drogowe ze stali nierdzewnej, 2 lub 3 częściowe.



Napędy i akcesoria

Napędy oraz szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych.

Jesteśmy dla Ciebie.

Gdziekolwiek kiedykolwiek.

**Jako firma międzynarodowa z
szerokim asortymentem produkcji
i usług, wspieramy naszych klientów
wiedzą techniczną i doświadczeniem
w różnych zakątkach świata.**

